

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技

股票代码：688019

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	天风证券、建信养老金
时间	2026年1月15日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 杨逊 证券事务代表 冯倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍： 介绍公司经营业务及未来发展规划。</p> <p>二、问答环节主要内容：</p> <p><b>Q：公司 CMP 化学机械抛光液产品主要包括哪些类别？我们注意到 2024 年公司在全球 CMP 市场的占有率已到 10%左右，能否介绍一下国内市场的情况？</b></p> <p><b>A：</b>公司的 CMP 抛光液已实现全品类产品线的布局 and 覆盖，已涵盖铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液等多个产品平台。同时，我们也依托化学机械抛光液技术和产品平台，针对不同客户在特色制程、新材料及新应用方面的需求，提供定制化解决方案，致力于为前道晶圆制造与后道先进封装提供一站式产品与服务。在国内市场，公司凭借全面的产品布局和领先的技术能力，已确立并保持了主流供应商的市场地位。国内市场是公司业务的坚实根基，我们也将继续深耕，与国内产业链协同发展，巩固并扩大这一优势。</p> <p><b>Q：越往先进制程发展，Fab 厂与供应商的合作通常会愈发紧密。我们有看到去年下半</b></p>

年开始，国内存储与先进逻辑领域的扩产势头持续增强，公司是如何规划自身的产能建设，在未来与客户协同发展过程中，是否可能会面临产能瓶颈的挑战？

A：在产能规划方面，公司基于战略发展规划、市场潜在需求以及过往实践经验，建立起“小步快跑、滚动规划”的动态平衡机制，旨在同步实现固定资产投资的稳健回报与对市场未来增量的敏捷响应。具体来说，我们会以 3-5 年为周期对行业发展与市场需求进行研判和评估，提前布局生产物理环境搭建，持续跟踪市场发展，动态化灵活推进产线投资与产能爬坡。这种模式使我们能够根据市场需求的预期变化，及时调整投入节奏与规模，确保产能不成为发展的瓶颈，同时也避免过度投入造成的资源沉淀，实现资产效率与市场响应速度的最优平衡。

**Q：展望未来 2-3 年，公司增长的主要动力有哪些？**

A：首先是受益于半导体产业的长期发展趋势，半导体材料市场持续增长，同时随着先进逻辑芯片、3D 存储芯片及异构集成技术的发展，工艺步骤的增加将进一步带动对晶圆制造与封装环节的材料需求。此外，客户产能的持续扩张以及国产化替代进程的加速，也将为公司产品的需求增长提供动力。从内部驱动来看，公司正通过积极拓展国际市场、努力进入全球主流半导体供应链，以及持续加大研发投入、推动产品迭代与性能升级，不断强化竞争力。通过提升产品性能并拓展品类，公司将进一步巩固和扩大核心产品的市场份额。内外部因素的协同作用，共同为公司的持续稳健增长提供支撑。

**Q：公司如何看待目前国内的行业竞争格局，以及相应的应对策略？**

A：行业竞争是市场发展的规律，良性的积极的竞争环境有助于推动整个产业链的进步与发展。对安集而言，公司始终聚焦于自身能力的持续提升，我们将依托深厚的技术积累和快速迭代的能力，深化与客户合作，保持市场地位稳固。同时，公司将竞争视为内在优化的动力，通过持续加强技术研发、提升客户服务质量、强化团队建设等多方面举措，系统性增强核心竞争力，保持并扩大行业领先优势。

**Q：公司是否有拓展新业务领域的计划？**

A：公司以化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂三大主营业务板

	块为核心，同时持续关注半导体材料领域横向拓展机会。在发展策略上，公司采用“内生式增长与外延式布局”相结合的方式，通过持续技术创新与战略布局，稳步拓展新业务领域与应用场景。
附件清单 (如有)	无
日期	2026年1月16日